



單液型環氧樹脂接著劑

產品簡介

JC531-5 為針對電子製品所開發的單液型環氧樹脂接著劑。本產品能夠形成強韌的結構，具有快速硬化、低膨脹、低收縮率的特性，耐熱性卓越。本產品具有優良的耐久性，可以通過許多不同的環境測試。本產品具有良好的操作性，適用於各種電子元件封裝、接著之用途。

產品特色

1. 本產品為無溶劑型的環氧樹脂。
2. 對於金屬及陶瓷具有良好的接著特性。
3. 在高濕度環境下，本樹脂仍然具有良好的電子絕緣特性。
4. 本產品符合 2011/65/EU RoHS 法規規範。
5. 本產品符合氯<900ppm，溴<900ppm，氯+溴<1500ppm。

樹脂規格

	JC531-5
外觀	液體
顏色	乳黃色
黏度 25°C, S14 20rpm, cps	40,000~80,000
觸變指數	1.5~2.0

硬化條件

可使用時間 25°C, days	7
完全硬化時間 120°C, min	60
完全硬化時間 150°C, min	30

使用方法

1. 本產品需要在冷凍庫(-40°C ~ -5°C)儲存，使用前請將產品放置於室溫(14~34°C)下 1~2 小時回溫。在尚未回溫前，請勿打開容器的蓋子，以免影響樹脂的特性。
2. 本樹脂所接著的表面應該乾淨清潔。建議先用有機溶劑擦拭表面，防止灰塵、油質和脫膜劑影響樹脂的接著效用。
3. 實際物品的硬化時間會受到下列因素影響：①物件的幾何形狀，②物件的材質特性，③接著劑的厚度，④加熱系統的效能。硬化的條件則需要以實際的物品和條件來做最後的確認。

成品性質*

玻璃轉移溫度(MDSC), °C	111
熱膨脹係數(<Tg), μm/m/°C	47
熱膨脹係數(>Tg), μm/m/°C	182
比熱 0°C, J/g°C	6.33
比熱 25°C, J/g°C	6.48
比熱 50°C, J/g°C	6.78
比熱 75°C, J/g°C	7.05
比熱 100°C, J/g°C	7.28
硬度 (Durometer) Shore D	86
比重	1.37
吸水率(25°C /24hr), %	0.41
吸水率(80°C /24hr), %	2.55
吸水率(97°C /1.5hr), %	1.27
伸長率, %	6.9
熱裂解溫度(TGA 10°C /min), °C	326
重量損失率@100°C,%	0
重量損失率@150°C,%	0
重量損失率@200°C,%	0
重量損失率@250°C,%	0.17
重量損失率@300°C,%	2.06
重量損失率@350°C,%	9.25
熱傳導係數, W/mK	0.3
熱阻抗係數, m ² K/W	0.01
體積電阻, ohm-cm	4.5*10 ¹⁵
表面電阻, ohm	4.5*10 ¹⁴
介電常數 1KHz	3.2

*試片硬化條件：120°C / 60 min

儲存環境

本產品需隔絕濕氣與熱源，以確保應有的儲存安定性。在未開封前存放於冷凍庫(-40°C ~ -5°C)，本產品保存期限 8 個月。請將本產品放置於室溫(14~34°C)下回溫一至兩小時後可正常使用，並請盡速使用完畢。如果在室溫下放置過久，將導致本產品黏度發生變化。

處置原則

某一些報導指出皮膚長期接觸環氧樹脂並不會誘發癌症病變。但是環氧樹脂中的某些成分仍然可能會刺激皮膚，導致發炎紅腫。當皮膚接觸到本產品時，應以肥皂水將皮膚清洗乾淨，絕對不要使用有機溶劑來清洗。吞服本產品對人體仍有毒性，一旦誤食，請馬上送醫診治。避免眼睛接觸到此產品，使用者若不小心沾到眼睛時，要立即以大量清水沖洗眼睛至少 15 分鐘以上再送醫診治。進一步的注意事項請詳見物質安全資料表。